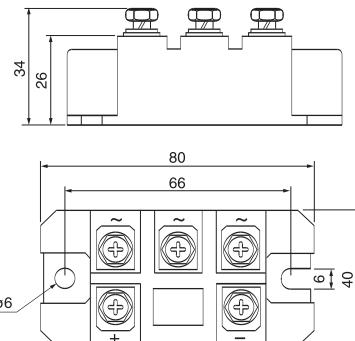
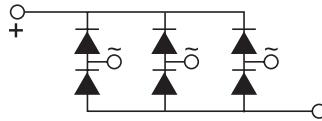


特性

- 1). 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
- 2). 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
- 3). 体积小, 重量轻

应用

I_o	100A
V_{RRM}	600~1600V
I_{FSM}	1.2 KA
I^2t	$7.2 A^2S*10^3$

外形尺寸图**参数**

符号	参数	测试条件	结温 T_j (°C)	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I_o	直流输出电流	三相全波整流电路, $T_c=100^\circ C$	150			150	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{RRM} tp=10ms V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150	600		1600	V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	at V_{RRM}	150			8	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms 正弦半波 $V_R=0.6V_{RRM}$	150			1.2	KA
I^2t	浪涌电流平方时间积					7.2	A^2s*10^3
V_{FO}	门槛电压		150			0.8	V
r_F	斜率电阻					4.5	$m\Omega$
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=100A$	25			1.30	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至壳)	单面散热				0.20	$^\circ C /W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散热器)	单面散热				0.07	$^\circ C /W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz,R.M.S,t=1min, $I_{iso}:1mA(max)$	2500				V
F_m	安装扭矩(M5)				4		$N\cdot m$
	安装扭矩(M6)				6		$N\cdot m$
T_{stg}	贮存温度		-40		125		$^\circ C$

性能曲线图

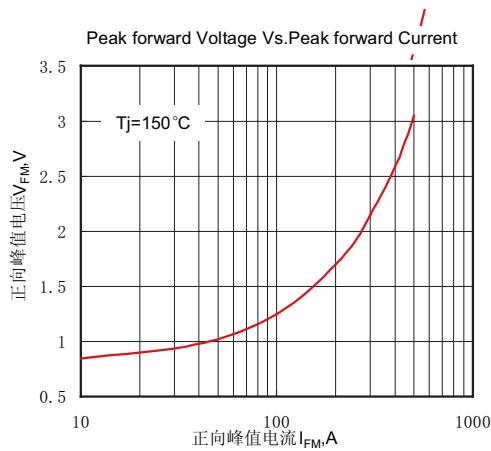


Fig.1 正向伏安特性曲线

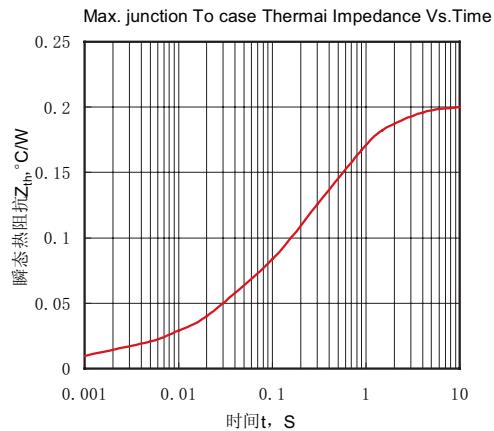


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

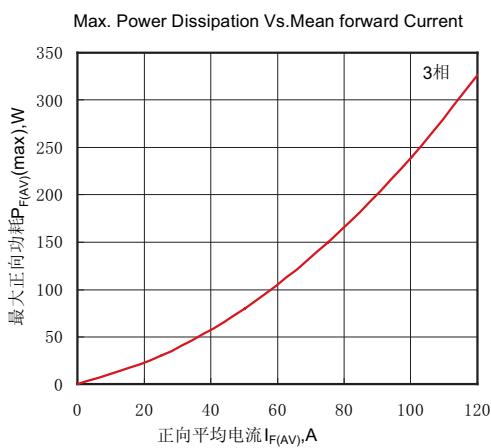


Fig.3 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

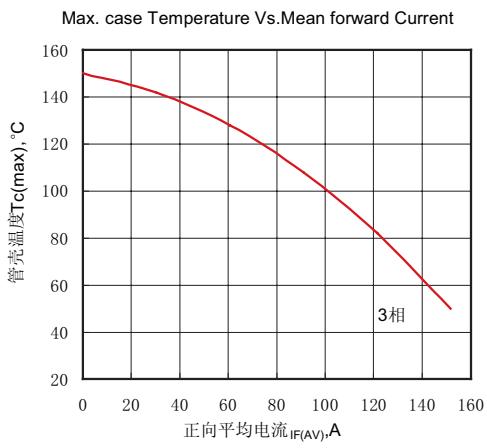


Fig.4 管壳温度与平均电流的关系曲线

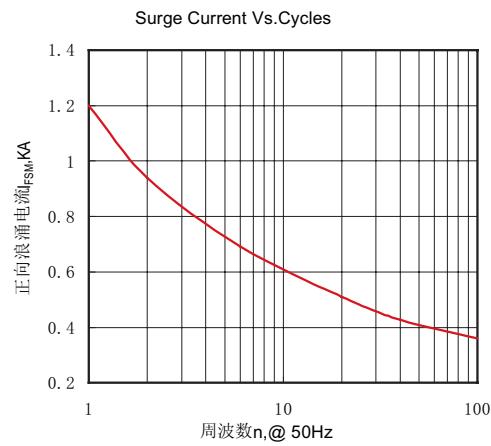
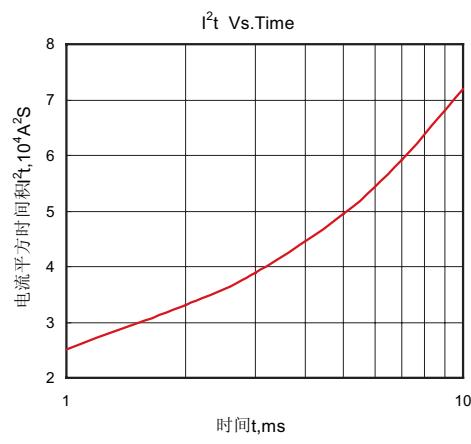


Fig.5 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

Fig.6 I^2t 特性曲线